

# MX2100™

集中カード発行システム

日々変化するカード発行ニーズに柔軟に対応するモジュールをそろえ、  
集中発行業務を強力にサポート

INSPIRED INNOVATION

## 集中カード発行システム

# MX2100™

MX2100™ 集中カード発行システムは  
IC カード発行に必要なキーテクノロジーをそろえ、  
様々なカード発行ニーズにお応えできるように設計されています。  
多彩な導入実績と豊富なノウハウが集約されたこのシステムは、  
モジュールごとに各機能が構成されており、  
お客様のニーズにあわせ、  
ベストな組み合わせでご提供が可能です。  
効率的、且つセキュアなカード発行業務をサポートいたします。

## 拡張性に優れるモジュラー

各機能はモジュール構成となっており、お客様の必要

## Featured Modules



### ラックマウントスマート カードモジュール

接触、非接触、デュアルインターフェースやコンピスマート  
カードのパーソナライゼーションに対応しています。

[仕様]

最大2モジュール接続可能  
接触型ICカード：1~11ステーション搭載可能  
非接触型ICカード：1~5ステーション  
(FeliCa R/W: 1~4ステーション)搭載可能



### シングルステップ カラーモジュール

全面印刷に対応しており、高解像度のフルカラー写真や  
イメージ、グラフィックスを高品質な仕上がりでプリント  
することができます。

[仕様]

最大1モジュール接続可能(クリーニングモジュール必須)、  
解像度300dpi、染料拡散熱転写方式

## 安心の高セキュリティシステム

マイクロソフトWindows 7を採用し、ホストデータの保存から転送、  
またカード発行中においてもセキュアな環境下でデータを管理します。

## 高品質な仕上がり

発行からカード上の情報検証までを最高1,200枚/時のスピードで処理。  
高品質な仕上がりのカードをスピーディに発行いたします。



# 設計・豊富なラインアップ

要望や発行規模、今後の拡張などに配慮し、システムを設計いたします。最大9モジュールまで拡張可。



## ビジョンヴェリフィケーション モジュール

ジョブに合ったカードがセットされているかを照合し、誤ったカードでの発行による、サプライ品の無駄を防ぎます。小ロット多品種のジョブを走らせる際に大きな効果を発揮します。また、カード発行後にパーソナライズされたグラフィックス情報を発行元データと照合する機能としても導入可能です。

[仕様]

最大1モジュール接続可能、  
カード照合:表裏対応



## 品質チェックモジュール

発行されたカードのエLEMENTを読み、発行データとの照合検証を行うことでカードの正確性と品質を保ちます。自動化により生産性をより高め、検証コストを軽減します。

[仕様]

1セット接続可能、検証可能ELEMENT: エンボス、インデント、トッピング、グラフィックス、カラープリント、レーザー、磁気ストライプ、ICデータ



## MXD™ Lite カード デリバリーシステム

発送フォームへの住所・宛名・カード情報の鮮明なプリント処理、発行したカードのフォームへ貼付けから折りたたみまでを一連で処理します。

[仕様]

最高 1,200枚/時、  
カード貼付け:最大4枚、  
フォームサイズ: A4/レター



## MXi™ 封入封かんシステム

カードを貼付した発送フォームと同封物の封入封かんまでを一連で処理します。インラインで処理されるため、個人情報が目に触れずに封かんすることが可能です。

[仕様]

最高 1,200枚/時、  
同封物:最大14点



## インテリジェント・サプライ・テクノロジー

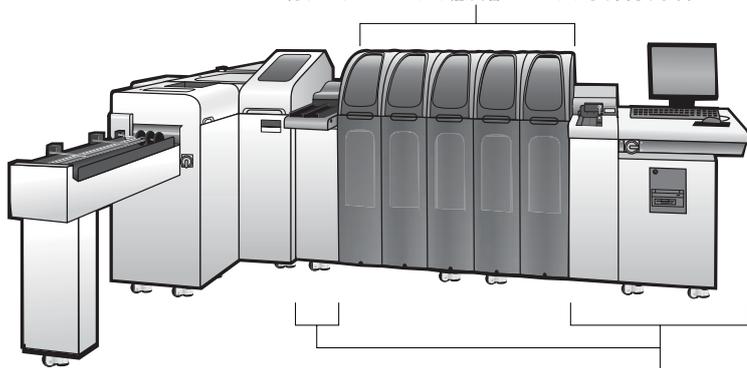
トッパーリボンやグラフィックス、トップコート等のサプライ品にはICチップが搭載されており、カード発行時に適切なサプライがセットされているかの管理や、リボンフィード量の最適化に加え、リボンの交換が必要になると自動的にコントローラー画面にメッセージを表示してお知らせする設計で、生産性の最大化をサポートします。

## 基本サイズ

### オプションモジュール (最大9)

(単位: mm)

1モジュール 幅:254、奥行:858.5、高さ:1,273  
(オプションモジュールの幅は、各モジュールにより異なります)



### ベースモジュール

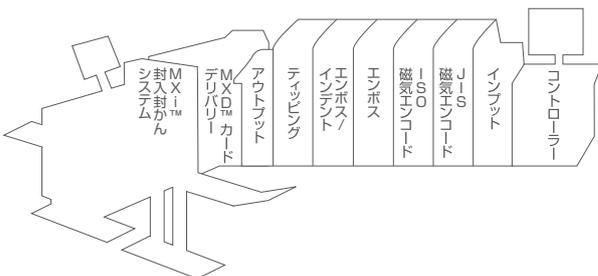
コントローラ 幅:610、奥行:858.5、高さ:1,273  
インプット 幅:254、奥行:858.5、高さ:1,070  
アウトプット 幅:254、奥行:858.5、高さ:1,070

## モジュール構成例

TYPE  
A



TYPE  
B



## 基本仕様

### ●ベースモジュール

項目	仕様
処理スピード	最高1,200枚/時
OS	Windows Embedded Standard 7
最大取り付けモジュール数	9モジュール
システムコントローラ	Intel Xeon E5-2430 ×2、メモリ-16GB、HDD500GB
電源仕様	230V 50/60Hz、30A(モジュール構成により別途追加電源が必要な場合があります)

### ●オプションモジュール

モジュール	機能
インプット	収容枚数500枚/1トレイ、最大4モジュール接続可能
クリーニング	デュアルクリーニング機構を採用したクリーニング専用モジュール 複数モジュール接続可能
磁気エンコード	JISエンコード(上、下、上下)、ISOエンコード
ラックマウントスマートカード(接触/非接触)	接触:1~11ステーション 非接触:1~5ステーション (FeliCa:1~4ステーション) コンビネーション:1~6ステーション 最大2モジュール接続可能
インプット	収容枚数500枚/1トレイ、1モジュール追加可能
グラフィックスプリント	解像度300dpi、溶融式顔料直接転写方式、表裏の2タイプ
シングルステップカラー	解像度300dpi、染料拡散熱転写方式、表処理(フリッパーモジュールにて裏面対応)
OCR-B/バーコードスキャナ	バーコードスキャンまたはOCR文字認識 カード片面
マルチカードバッファ	カード自動再作成モード時のカード順保持/処理スピードの平均化
ベシクトップコート	グラフィックスやカラー印字を保護するためにクリア又はホログラフィックオーバーレイをカード全面に貼り付け
カードガード	エンボス加工が可能な紫外線硬化樹脂でプリント面を保護
エンボス	最大112文字の活字を収容、最大2モジュール接続可能
ティッピング	エンボス加工した文字の着色、リボン残量および色の自動判別機能付(インテリジェントサブライ使用時)
ビジョンベリフィケーション	カード券面(表裏)の印刷済み、またはパーソナライズされたグラフィックステキスト・ロゴ等を識別しデータと照合
ラベル・アフィクシング	ラベルのカード貼り付け(カードへ貼り付け後にグラフィックスプリントモジュールで印字可能)
フリッパー	カード反転モジュール
品質チェック	カード券面の光学的エレメント(印刷済み、またはパーソナライズされたグラフィックステキスト・ロゴ等)、または電子的エレメント(磁気ストライプ、ICデータ)の検証
アウトプット	収容枚数500枚/1トレイ(リジェクト専用トレイあり) 最大1モジュール(7トレイ+1リジェクトトレイ) 接続可能
MXD™ Liteカード デリバリ-システム	発送フォームへの印字、カード貼付、フォーム折りまで処理(折りは最大3種)。両面プリント対応、処理スピード:最高1,200枚/時(カード貼付枚数で異なります) ※フォームは折らずに排出できません
MXi™封入封かんシステム	カード貼付済み発送フォームと同封物を封筒へ封入封かん処理(同封物最大14点)。同封物セット数…シングルフィーダー:350部(同封物厚み最大4mm)、タワーフィーダー:上部250部(同封物厚み最大2mm)下部250部(同封物厚み最大4mm)

※Datacardロゴ、MX2100、MXD、MXiは米国データカードコーポレーションの商標または登録商標です。 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※Intel、Xeonはアメリカ合衆国およびインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 ※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

 **Entrust Datacard™**  
日本データカード株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル

TEL : 03-3494-6131

https://www.datacard.co.jp/

